

研究成果報告書 (掲載期間 2023.11.1–2024.10.31)

学術書

- (1) 山田靖他：次世代パワーデバイスに向けた高耐熱高放熱材料の開発と熱対策，第3章第8節，技術情報協会，2024.

学会発表

- (1) K. Hidaka, A. Imai, S. Suzuki, J. Matsui, T. Sawamura, Y. Koga, Y. Yamada, S. Yasaka, H. Habuka : Power Module Evaluation Using High Heat Dissipation and High Heat Resistance Resin Sheet Containing Boron Nitride Filler, PCIM Europe 2024, 2024年6月, Germany.
- (2) 山田靖：パワー半導体実装用接合技術と高温動作モジュール，よこはま高度実装技術コンソーシアム，第57回実装技術 세미나，2024年8月，オンライン開催
- (3) 山田靖：パワー半導体実装用接合技術と高温動作モジュール，エレクトロニクス実装学会，第38回春季講演大会，2024年3月，千葉.